



「各種アプリケーションから見たワイドギャップ半導体への期待」

◇ 日時: 2018年1月30日(火) 14:00~18:00

◇ 場所: 大阪中央公会堂 3F 小集会室、大阪市北区中之島1丁目1-27

(大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅 1番出口より徒歩5分、<http://osaka-chuokokaido.jp/map/>)

Si、SiC、GaNなどの先進パワー半導体デバイスは、アプリケーションが要求する使用条件、耐久性・信頼性、耐環境性などに応じ、適材適所での活用が期待される。そこでは、素子の構造と駆動方法の要素が重要である。例えば、各半導体デバイスの長所を活かす回路トポロジーや回路スペックの議論を通じて、最適なアプリケーションを検討することや、求められるデバイス性能、信頼性について議論し、駆動や保護制御などの視点を加え、ワイドギャップ半導体の活用のありかたを考えることは有意義である。本研究会では、幅広い応用分野からのご講演を通じ、其々のデバイスが目指すべき方向性を明らかにする。

..... プログラム

開会のあいさつ 14:00~14:05

先進パワー半導体に適したパワーエレクトロニクス回路技術 14:05~14:45
山本 真義 (名古屋大学)

電力制御に向けたパワーエレクトロニクス回路、デバイス 14:45~15:25
舟木 剛 (大阪大学)

人工衛星に使用するパワーデバイスの宇宙線耐量 15:25~16:05
大村 一郎 (九州工業大学)

休憩 16:05~16:25

パルスパワー電源開発に伴うパルスパワー応用の進展 16:25~16:55
秋山 秀典 (融合技術開発センター)

原子力分野で求められる耐放射線デバイス 16:55~17:25
大西 献 (三菱重工業)

Robust power electronics for underground resource exploration 17:25~17:55
Dr. Harmel Defretin (Schlumberger)

閉会のあいさつ 17:55~18:00

.....
■参加受付: WEB 参加受付システム(ここをクリック*)から参加登録をお願いします。1月20日の登録状況でテキスト印刷部数を決定しますので、以後の登録ではテキストを当日お渡しできない可能性があります。

*本案内が印刷物の場合、<http://annex.jsap.or.jp/adps/pdf/kenkyuukai10.pdf> よりアクセスして下さい。

■参加費: (テキスト代・消費税込) 当日会場にてお支払いください。

先進パワー半導体分科会会員* 2,000円、分科会学生会員 1,000円、一般 4,000円、一般学生 1,000円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

問合せ先:

多留谷 政良 (三菱電機)	TEL: 092-805-3289	e-mail: Tarutani.Masayoshi@da.MitsubishiElectric.co.jp
西脇 克彦 (トヨタ自動車)	TEL: 0565-46-3315	e-mail: katsuhiko_nishiwaki@mail.toyota.co.jp
石田 昌宏 (パナソニック)	TEL: 070-2677-0687	e-mail: ishida.masahiro002@jp.panasonic.com
田中 保宣 (産業技術総合研究所)	TEL: 029-861-5691	e-mail: yasunori-tanaka@aist.go.jp
五十嵐 周 (応用物理学会事務局)	TEL: 03-3828-7723	e-mail: divisions@jsap.or.jp